

证券代码：688603

证券简称：天承科技

广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	华夏基金、泰康基金、太平养老保险、富国基金、农银汇理、环懿基金、泉果投资、川流投资、东正自营、兴银理财、阿杏投资、运舟基金、荃笠资产、歌汝投资、瑞银资管、永盈基金、弘毅远方基金、墨钜资产、翀云基金、海富通基金、远海基金、野村资管、一点五度创投、国泰君安资管、汐泰投资、中信建投、浙商电子、华鑫证券、东兴证券、兴业证券、中泰证券、中信证券、民生证券、长城证券、方正证券、德邦证券、财通证券	
调研时间	2024年10月15日（周二）14:00-16:00	
会议地点	上海市金山区春华路299号（上海天承化学有限公司）	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：费维 CTO、半导体业务负责人：韩佐晏	
投资者关系活动主要内容记录	<p>（一）请问公司近期PCB领域的营业情况如何？</p> <p>答复：</p> <p>得益于2024年下游PCB制造领域景气度回暖，以及公司不断优化高毛利率产品销售比例、不断拓展高端客户，近期公司PCB电子化学品出货量有不错的提升，整体经营情况稳健且持续增长。</p> <p>（二）请问公司目前半导体事业部的组建情况如何？</p> <p>答复：</p> <p>韩佐晏博士目前是公司的新任CTO，同时兼任公司的半导体事业部负责人。韩博过往在陶氏、杜邦以及华为2012实验室的工作经历，</p>	

令其具备了丰富的电子电镀相关产品的开发经验、战略规划和国际视野。韩博现已组建了包含研发、生产、质量和销售等环节的半导体团队，并形成完整的半导体事业部运作机制。对于从先进封装到先进制程相关的电镀产品实现了全覆盖，把公司配方型电子化学品在PCB(含封装基板)全覆盖的能力拓展到了芯片领域。同时韩博对未来的前瞻性产品已经有所布局，韩博当前在建立天承科技新的高端材料研发平台，持续点燃天承科技未来的核心内驱力。

(三)请问在晶圆级前道电镀添加剂和先进封装电镀添加剂领域公司的主要竞争对手是谁?

答复:

公司在这块的主要竞争对手为国际知名的电子化学品巨头和领导者。晶圆级前道电镀添加剂领域的竞争对手有莫西湖、英特格和巴斯夫等，先进封装电镀添加剂领域的竞争者主要包括麦德美乐思，杜邦和安美特等。

(四)请问公司在半导体先进封装、先进制程领域的布局计划如何?

答复:

公司致力于在未来2年内成为国际、国内主流封测客户的主要供应商。公司3年内争取实现30%以上从先进封装到晶圆制造的电镀添加剂国内市场份额。

(五)请问公司先进封装领域的电镀添加剂目前验证进展如何?

答复:

公司先进封装的产品主要聚焦于电镀铜柱、再布线层、硅通孔和玻璃通孔填孔电镀等产品，相关的产品和技术已经完成配方开发、并持续在下游客户产线验证，目前获得的测试结果都较好，符合客户的预期。

(六)先进制程大马士革电镀液产品推向市场的进度和策略是?

答复:

相比于先进封装领域，先进制程大马士革产品不仅需要创新的配方设计，同时对生产工艺中金属杂质、颗粒度管控等提出更高的要求。

	<p>公司希望当前聚焦先进封装产品，把质量做好、做扎实，然后持续推动技术创新和产品迭代，逐步布局到先进制程。此外，目前晶圆厂都以稳定产线和提升良率为首要目标，评估新技术和产品的周期较长，我们持续与客户保持交流和沟通，在合适的时机推出相关产品。</p> <p>(七) 请问公司 TGV 电镀产品目前的进展如何，TGV 和 TSV 电镀产品的主要差异是什么？</p> <p>答复：</p> <p>公司目前正与十多家下游多家客户持续测试验证中，同时已实现小批量产品销售，现正在与设备厂商、客户合作积极推动相关技术成熟落地。相比于 TGV，TSV 通常开口直径小，深径比更大，需要解决硅通孔底部的药水交换。而 TGV 填孔电镀的难点在于如何快速实现通孔中部的连接以及提升电镀工艺的效率。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 10 月 16 日